

# 5th ICMSSM2019

【EI 检索】2019 年第五届机械结构与智能材料国际会议

2019 年 5 月 27 日-28 日|中国, 西安

<http://www.icmssm.org/>



## Calling for papers/abstracts/listeners

### 会议简介

2019 年第五届机械结构与智能材料国际会议(5th ICMSSM2019)将于 2019 年 5 月 27 日-28 日在中国西安召开。此次会议旨在为广大专家、学者、技术人员提供一个高水平科学信息交流平台, 欢迎广大学术精英的加入。

### 出版检索

ICMSSM2019 经同行专家评审录用的论文将全部出版在会议论文集上, 收录在国际期刊 "Materials Science Forum" [ISSN print 0255-5476 ISSN cd 1662-9760 ISSN web 1662-9752, Trans Tech Publications], 被录用的所有论文都将出版在会议论文集, 提交主要数据库 (EI, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR 等) 检索。

您可以作为听众, 演示者 (海报) 或作者 (全文) 参加会议

### 重要日期

论文截稿时间: 2019 年 5 月 31 日

录用通知日期: 2019 年 6 月 7 日

注册截止日期: 2019 年 6 月 14 日

会议日期: 2019 年 5 月 27 日-28 日

### 会议主题 (包括但不限于)

T1: 材料科学与工程

T2: 机械工程和机电一体化

T3: 材料科学和技术

### 投稿方式

1. CMT 投稿系统:

<https://cmt3.research.microsoft.com/ICMSSM2019>

2. Email: [cfp@icmssm.org](mailto:cfp@icmssm.org)

### 往届会议



### 联系方式

联系人: 颜老师

邮箱: [cfp@icmssm.org](mailto:cfp@icmssm.org)

电话: +86-24-8395 8379 -803

QQ: 2947191913

微信: 13125407442

网址: <http://www.icmssm.org>



**ttp** trans tech publications inc.  
Publishers in Materials Science Forum

Compendex on  
Engineering Village